

第35回マイクロエレクトロニクスシンポジウム2025



MES2025 参加募集

開催日・講演発表日：2025年9月3日(水)～5日(金)

開催会場：大阪大学中之島センター（大阪市） & オンライン開催

交流会：9月4日(木)18時開始予定 会場：レストランアラスカ フェスティバルタワー

参加申込期間：5月1日～9月2日 7月31日まで早割価格！

《MES2025ホームページ》* 詳細および最新の情報はこちらからご参照ください

<https://jiep.or.jp/event/mes/mes2025/>

◆特別講演◆ 9月4日(木)午後予定

1. 「2030年に向けた半導体未来シナリオ（仮）」

大野 誠 氏（インテル株式会社 代表取締役社長）

ポスト5G時代を見据えて、半導体、AI、量子コンピューターがどのような進化を遂げ、我々のビジネスや生活環境にどんなインパクトを及ぼすかについて、いくつかの未来シナリオを踏まえ、将来の可能性について説明していきたい。



2. 「産業の川上「結晶」が拓くグリーン・デジタル社会」

森 勇介 氏（大阪大学大学院工学研究科
電気電子情報通信工学専攻 教授）

現在、「半導体」という言葉を聞かない日が無いくらい、半導体が注目されています。その理由は、半導体の進歩が社会変革に直結するからです。その事例としては、ChatGPTのようなロジック半導体に関与する技術や省エネに直結するパワー半導体技術、そしてその融合分野としてのIoTがあります。これらの技術の進化には「結晶」の進化が不可欠です。

本講演では、「結晶」が半導体産業に与えるインパクトについて述べます。



特別セッション

- ・特別企画セッション
- ・ロードマップセッション
- ・電子デバイス実装研究委員会 共催（スマートプロセスエレクトロニクス生産部会）
- ・その他 調整中

マイクロエレクトロニクスシンポジウム2025 (MES2025)

企業展示

(株)三ツフロンテック

丸文(株)

タカヤ(株)

奥野製薬工業(株)



(株)日立パワーソリューションズ

(同)ブリマテック

ディー・エイ・インストゥルメント・ジャパン(株)

(株)サーモグラフィティクス

テクノアルファ(株)



レーザーテック(株)

(株)図研

サンユレック(株)



参加費一覧

聴講・参加、オンライン視聴、予稿データダウンロード含む

(消費税込み)

発表者・聴講者(参加者)		参加登録期間	早期 参加費 2025年7月31日迄	通常 参加費 2025年8月1日~9月5日迄
参加(聴講)者	会員	正会員	15,000円	17,000円
		海外会員	15,000円	17,000円
		若手会員	15,000円	17,000円
		シニア会員	7,000円	9,000円
		学生会員	3,500円	4,000円
		名誉会員	無料	
口頭発表者	賛助会員	賛助会員	15,000円	17,000円
		クーポン	使用可(無料)	
ポスター発表者	共催会員	一般	15,000円	17,000円
		学生*	3,500円	4,000円
	協賛会員	一般	20,000円	22,000円
		学生*	4,500円	5,000円
非会員	一般	28,000円	30,000円	
	学生*	5,500円	6,000円	

*学生はいずれも交流会参加費込

オプション		
オプション	交流会参加費(先着160名)	6,000円
	予稿集冊子版(国内発送のみ)	4,000円

企業展示(企業セッション)	参加登録期間	参加登録費 2025年6月13日迄	特権
企業展示	会員	正会員	80,000円
		共催会員	
		賛助会員	
	非会員	協賛会員	100,000円
一般		130,000円	
企業展示登録後	補助員	1名につき ※	15,000円

※ 1名無料 (聴講費、予稿データダウンロード)

※参加者氏名にて登録ください(複数名参加は人数分の登録が必要です)

【協賛団体】予定

IEEE EPS Japan Chapter, 映像情報メディア学会, 応用物理学会, 化学工学会, 関西サイエンス・フォーラム, KEC関西電子工業振興センター, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電子情報技術産業協会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本電子材料技術協会, 日本ロボット工業会, 光産業技術振興協会, 表面技術協会, 溶接学会, 粉体粉末冶金協会, 日本電子回路工業会

主催：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2

お問合せMail：E-mail: mes2025@jiep.or.jp

ホームページ: <https://jiep.or.jp>



共催
予定

大阪大学接合科学研究所

